



头豹
LeadLeo

2025年

半导体金属靶材行业词条报告

头豹分类/制造业/专用设备制造业/电子和电工机械专用设备制造/半导体器件专用设备制造、头豹分类/制造业/金属制品业/铸造及其他金属制品制造

企业竞争图谱：2025年半导体金属靶材 头豹词条报告系列



文上·头豹分析师

2025-07-11

未经平台授权，禁止转载

行业分类：制造业/半导体器件专用设备制造

制造业/铸造及其他金属制品制造

摘要

金属靶材是半导体制造中的关键耗材，其性能直接影响芯片质量。半导体金属靶材行业壁垒高，需巨额资金和技术支持。2024年起，中国金属靶材出海市场加速增长，预计2030年达到41.3亿元。该行业发展与半导体行业周期紧密相关。市场规模增长受市场需求、技术进步和政策支持等因素推动。未来，随着政策支持力度加大、新型市场崛起和产业逐步升级转型，金属靶材市场有望进一步发展。

行业定义

金属靶材是在溅射、蒸镀等薄膜制备工艺中作为原材料靶材使用的金属材料。在溅射过程中，利用高能离子束轰击靶材表面，使靶材表面的原子或分子获得足够的能量而脱离靶材表面，沉积在基底（硅片、玻璃等）上，从而形成一层均匀的薄膜。靶材主要通过物理气相沉积（PVD）或化学气相沉积（CVD）工艺，在晶圆表面形成金属薄膜的关键耗材，其性能直接影响芯片的导电性、可靠性和良率。

金属靶材是半导体超高纯金属材料的核心应用形态。从产业链地位看，靶材是连接超高纯金属材料和半导体制造的桥梁，具有小材料、大作用的特点，决定了90%以上的互连性能。

行业分类

半导体金属靶材的分类方式多样，可根据材料成分、应用场景、制备工艺等维度划分。

根据材料成分划分

可分为铜靶材、铝靶材、钛靶材、钨靶材和钼靶材等。

铜（Cu）靶材

高导电性、良好延展性，常用于半导体芯片的互连布线（铜互连技术）。半导体领域需达到6N（99.9999%）以上，以减少杂质对电性能的影响。应用于7nm及以下先进制程的逻辑芯片、3DNAND存储芯片的金属层制备。

铝（Al）靶材

成本低、导电性优良，早期广泛用于芯片制造，现逐步被铜靶替代，但在功率器件、显示面板中仍占重要地位。半导体用高纯铝靶需5N5（99.9995%）以上，新疆众合已实现超高纯铝基靶材坯料国产化。

钛（Ti）靶材

高熔点、耐腐蚀性强，常作为粘附层或扩散阻挡层（如Cu/Ti多层布线结构）。芯片制造中阻挡层，防止铜离子扩散至硅基底。

钨（W）靶材

高熔点（3422℃）、低电阻率，用于制备接触孔和通孔栓塞（Plug）。逻辑芯片中的局部互连层，如14nm以下制程的钨栓塞工艺。

钼（Mo）靶材

高温稳定性好，常用于薄膜晶体管（TFT）、太阳能电池背电极。AMOLED显示面板的源漏电极、HJT太阳能电池的背场接触层。

行业特征

半导体金属靶材的行业特征包括半导体金属靶材行业壁垒高、金属靶材出海市场加速增长、行业受半导体周期影响显著。

1 半导体金属靶材行业壁垒高

半导体靶材的研发和生产需要巨额资金支持，建设一条半导体级高纯金属生产线需投资数亿元，对于技术标准、靶材纯度、晶粒尺寸、产品体系均有极高的要求。此外，研发一种新型靶材需要3-5年时间和数千万元的投入，通过客户认证过程中的小批量试产和测试也需要企业承担高昂成本。这些投入在短期内难以产生现金流回报，要求企业具备强大的资金实力和长期投入的耐心，因此使得其他应用领域的金属靶材玩家较难进入半导体用靶材领域。

2 金属靶材出海市场加速增长

2024年，中国金属靶材出海市场呈现加速增长态势，预计2025年中国金属靶材出海市场规模出口额超过20亿元。随着中国各头部靶材企业加速扩大产能的同时，全球显示产业链向东南亚转移以及中国靶材企业在性价比和服务响应上的竞争优势，中国金属靶材出海市场预计加速增长，预计到2030年达到41.3亿元，2025-2030年复合增长率为14.9%。

3 行业受半导体周期影响显著

金属靶材行业作为半导体产业链的关键环节，其发展与半导体行业周期呈现强绑定关系。半导体行业特有的“硅周期”（即供需波动引发的产能、价格周期性变化）对金属靶材的市场需求、价格走势、企业盈利等维度产生显著影响。

发展历程

中国金属靶材行业经历了萌芽期、启动期和高速发展期，目前正处于高速发展期。随着金属靶材行业的加速发展，中国半导体金属靶材在全球市场的地位不断提升，实现了部分产品的进口替代，并开始向海外市场出口。同时，行业的发展也带动了上下游相关产业的协同发展，技术水平快速提升，部分产品达到国际先进水平。

萌芽期 · 1950-01-01~1980-01-01

中国半导体行业处于起步阶段，相关技术主要依靠国际进口，靶材领域的研究和生产也刚刚开始，主要是一些科研机构 and 少数企业进行初步探索，对靶材的需求较少，市场规模小。为后续靶材行业的发展奠定了一定的技术基础和人才储备，让中国对靶材有了初步的认识和了解。

技术依赖进口，自主研发能力弱，生产规模小，产品主要满足本土少量的半导体研究和简单生产需求。

启动期 · 1981-01-01~2005-01-01

中国对半导体产业的重视程度逐渐提高，部分企业开始专注于靶材的研发和生产，但整体技术水平与国外仍有较大差距。靶材企业不断尝试突破技术瓶颈，努力提高产品质量和性能。2005年，江丰电子生产出第一块国产半导体工业应用溅射靶材，填补了中国溅射靶材工艺的空白。江丰电子的突破标志着中国半导体金属靶材行业开始走上自主发展的道路，增强了本土企业在该领域的信心，吸引了更多的企业和资本进入，推动了行业的发展。

行业内企业逐渐增多，技术研发投入增加，开始取得一些关键技术突破，国产化进程开始起步，但在高端产品上仍依赖进口，市场份额较小。

高速发展期 · 2006-01-01~2025-01-01

以江丰电子、阿石创、有研新材等为代表的本土靶材企业不断加大研发投入，在技术创新、产品质量和市场开拓等方面取得显著成效。一方面，企业通过自主研发和技术创新，不断提高靶材的纯度、性能和质量，逐步打破国外企业的技术壁垒和市场垄断。另一方面，随着中国半导体、平板显示、太阳能电池等行业的快速发展，对靶材的需求不断增加，为靶材企业提供了广阔的市场空间。此外，国家也出台了一系列支持政策，如税收优惠、研发补贴等，进一步推动了行业的发展。

技术水平快速提升，部分产品达到国际先进水平；市场规模迅速扩大，企业营收和利润持续增长；国产化进程加速，国内企业在全球市场的竞争力不断增强；政策支持力度大，产业发展环境良好。

产业链分析

半导体金属靶材产业链的发展现状

半导体金属靶材产业链是一个技术密集型的产业体系，对半导体产业的发展至关重要。产业链各环节紧密相连，上游原材料和设备供应的稳定性与质量，直接影响中游靶材制造的品质和成本；中游靶材制造的技术水平和生产能力，决定了能否满足下游半导体行业不断增长的需求；下游半导体行业的发展趋势和技术革新，则推动着整个产业链的技术进步和产品升级。同时，由于半导体金属靶材行业技术壁垒高，日美厂商在全球市场占据主导地位，本土企业在实现国产化替代的过程中，需要不断加大研发投入，提升技术实力。

半导体金属靶材行业产业链主要有以下核心研究观点：

产业链上游原材料供应的重要性与挑战并存。

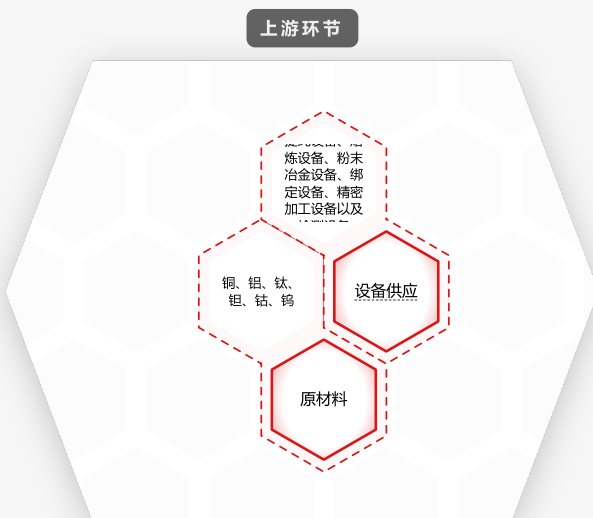
有色金属产量增长为靶材制造提供了一定原材料保障，2024年中国十种有色金属总产量7,919万吨，比上年增长4.3%。但半导体金属靶材对原材料纯度要求极高，通常需达到99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。中国在高端原材料领域部分仍需依赖进口，这对产业的自主可控发展带来挑战。但是，中国企业也在努力提升自给率，新疆众合的超高纯铝基靶材坯料已实现批量和工业化输出。

产业链下游应用领域中，半导体芯片制造是关键驱动力。

全球半导体市场规模不断增长，根据WSTS数据，全球半导体市场规模由2019年的4,123亿美元增长至2024年的6,202亿美元。在AI芯片需求强劲的推动下，全球半导体行业将有所回暖，开始进入上行周期。预计2025年市场规模可达到6,971亿美元，同比增长12.4%。晶圆制造是半导体溅射靶材最主要的需求来源，占据大约61%的市场份额。随着半导体技术向7先进逻辑器件、新型存储器件、三维集成等方向发展，对靶材的纯度、性能和精度要求将越来越高，推动靶材技术不断创新和升级。

产业链上游环节分析

半导体金属靶材上游环节



生产制造端

原材料与相关工艺设备

上游厂商

上海同创普润新材料有限公司

先导电子科技股份有限公司

有研新材料股份有限公司

宁夏东方钽业股份有限公司

中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司

湖南先导稀有金属材料有限公司

江西钨业控股集团有限公司

上游分析

上游原材料种类广泛，并且对金属纯度要求极高。

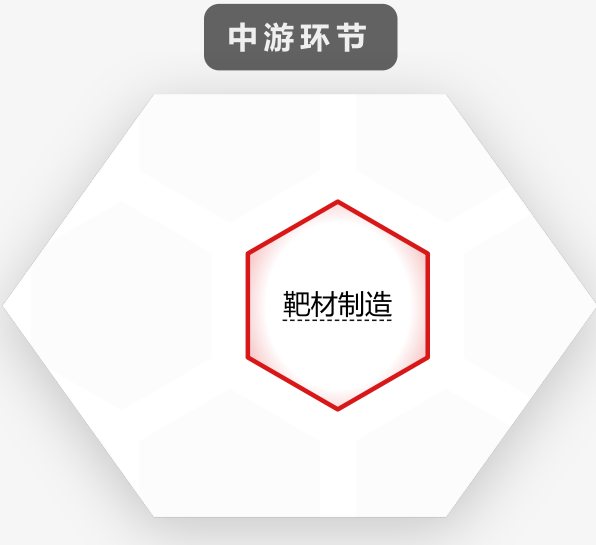
上游原材料供应主要包括各种高纯度金属，如铜、铝、钛、钽、钴、钨等，这些金属的纯度要求通常达99.9995%（5N5）甚至99.9999%（6N）以上。有色金属冶炼行业为靶材制造提供基础金属材料，其产量和质量影响着靶材的供应和性能。此外，部分特殊的合金材料和化合物也用于靶材制造，对其成分和性能的精确控制是关键。2024年，中国十种有色金属总产量7,919万吨，比上年增长4.3%。其中，精炼铜产量达1,364万吨，同比增长4.1%；电解铝产量4,400万吨，同比增长4.6%。这些关键有色金属产量的增长，为靶材制造商获取高质量原材料提供了一定保障。此外，中国在一些稀有金属的产量上也占据重要地位，如2024年中国的钨矿产量达到6.7万公吨，钼产量为11万公吨，铟产量为760公吨，均位于全球首位，精炼碲产量为750公吨，占到全球约76.53%，精炼铋产量为1.3万公吨，占到全球约81.25%，这对于生产含这些稀有金属的靶材具有重要意义。

靶材生产涉及多种设备，仅部分高精度检测设备仍依赖进口，大部分设备已实现国产化。

上游设备涉及提纯设备、熔炼设备、粉末冶金设备、绑定设备、精密加工设备以及检测设备等。这些设备的精度和性能对靶材的生产工艺和产品质量起着重要作用。先进的提纯设备能够提高金属原料的纯度，精密加工设备可以保证靶材的尺寸精度和表面质量。目前，部分高精度的检测设备，国际品牌在市场上占据主导地位。但是，本土设备企业也在不断加大研发投入，努力提高设备的国产化率，以降低靶材生产成本，提高产业的整体竞争力。

中产业链中游环节分析

半导体金属靶材中游环节



品牌端

半导体金属靶材制造厂商

中游厂商

日矿金属

宁波江丰电子材料股份有限公司

北京普莱克斯实用气体有限公司

霍尼韦尔（中国）有限公司

日本东曹

林德

世泰科

中游分析

靶材制造工序繁多，技术难度高，需要多项核心技术。

靶材制造包括高纯金属纯度控制及提纯技术、晶粒晶向控制技术、异种金属大面积焊接技术、金属的精密加工及特殊处理技术、清洗包装技术等。这些技术的掌握程度直接影响靶材的质量和性能。晶粒晶向控制技术能够影响薄膜的均匀性和性能，异种金属大面积焊接技术对于保证靶材的结构稳定性和导电性至关重要。

中游制造已实现国产化能力，国产化率也在加速提升。

尽管目前中国在高纯金属靶材领域已实现国产化能力，但在国产化率仍存在较大提升空间。当前半导体钽靶材国产化率在35%-40%之间，铝靶材国产化率已超过50%，铜靶材国产化率在50%左右。从市场现状和竞争格局来看，各金属靶材正在加速由海外供应转向国产替代的过程。由此判断，随着技术突破与国产替代进程加快，中国相关企业在未来有望显著受益于国产化率的持续提升。

中游企业已逐渐开始拓展出海机遇，出海市场加速增长。

从金属靶材区域分布来看，亚洲是中国靶材出海的主要目的地，其中东南亚（越南、马来西亚、印度）出口主要为供应当地新建的面板厂和光伏组件厂，出口韩国和中国台湾主要为封装环节用靶材。此外，中国金属靶材出口欧洲与美国占比较少，以高价值的半导体的钽靶材为主，但目前美国通过《芯片与科学法案》，要求半导体企业减少对单一国家（尤其是中国）的供应链依赖，因此美国出海市场存在一定限制。从出口产品结构来看，呈现明显差异化特点。（1）半导体用靶材中，钽靶出口较多，主要因为钽靶材的技术门槛较高，且附加价值高，海外产能供应上较为紧张。（2）显示用靶材中，钼靶和旋转铜靶是出口主力，主要供应京东方、TCL华星等在越南、印度的海外工厂；ITO靶材出口量增长迅速但基数仍低，主要因高端ITO靶材仍被日韩企业垄断。

下 产业链下游环节分析

半导体金属靶材下游环节



渠道端及终端客户

应用领域

渠道端

- 半导体制造
- 平板显示器
- 太阳能电池
- 信息存储
- 光学应用

下游分析

下游半导体芯片制造是半导体金属靶材最重要的应用领域之一。

在晶圆制造环节，靶材主要被用作金属溅镀，常采用物理气相沉积（PVD）工艺进行镀膜，用于制备芯片的金属互连层、阻挡层等结构。在芯片封装环节，靶材常用作贴片焊线的镀膜。随着半导体技术的不断发展，集成电路中的晶体管 and 线宽的尺寸越来越小，对靶材的性能要求也越来越高，推动溅射靶材逐步向大尺寸、多品种、高纯度化发展。根据WSTS的数据，全球半导体市场规模由2019年的

4,123亿美元增长至2024年的6,202亿美元。在AI芯片需求强劲的推动下，全球半导体行业将有所回暖，开始进入上行周期。预计2025年市场规模可达到6,971亿美元，同比增长12.4%。

除半导体芯片制造，半导体金属靶材还应用于平板显示器、太阳能电池、信息存储、光学应用等领域。

在平板显示器中，用于制造薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）等；在太阳能电池中，有助于提高电池的转换效率和稳定性；在信息存储领域，用于磁记录介质的制备；在光学应用中，可用于制造光学薄膜等。这些领域的发展也为半导体金属靶材市场提供了广阔的增长空间。

行业规模

半导体金属靶材行业规模的概况

全球金属靶材主要包括铜靶材、钽靶材、铝靶材、钛靶材，此外其他金属靶材还包括钴、钨、金、银、合金等靶材，产值占比较小。其中，钽靶材市场规模最大，其价值较高，行业平均价格为800-1,000万元/吨之间；此外，全球铜靶材中，铜锰合金靶材价值量较高，且细分市场正在加速增长；铝靶材市场稳定增长，平均价格在40万元/吨左右。整体来看，预计2025年全球半导体领域金属靶材市场规模达到196.67亿元，预计到2030年市场规模达到314.44亿元。

半导体金属靶材行业市场规模历史变化的原因如下：

受到市场需求增速、市场环境变化影响，半导体金属靶材行业市场规模在稳定增长。

随着电子产品不断向小型化、高性能化发展，半导体芯片的集成度越来越高，对金属靶材的需求持续增加。在芯片制造的光刻、蚀刻等工艺中，需要使用高精度、高纯度的金属靶材来制备导电路路和阻挡层等。全球半导体产业的不断扩张，新建晶圆厂、增加产能等，直接推动了金属靶材市场的增长。此外，2020-2024年期间，全球经济总体保持增长态势，尽管受到宏观环境等因素的影响，但在各国的经济刺激政策下，经济逐渐复苏。经济的增长带动了消费市场的需求，半导体、电子产品、太阳能电池等金属靶材下游产品的市场需求增加，从而推动了金属靶材市场的发展。

靶材制备技术提升和新兴靶材研发成功，推动市场规模加速发展。

随着材料科学和工艺技术的不断进步，金属靶材的制备技术得到了显著提升。物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积等先进的镀膜技术的发展，使得金属靶材的纯度、密度、均匀性等性能得到了大幅提高，能够满足下游行业对高品质靶材的需求。此外，全球头部企业研发出一系列新型金属靶材，包括高性能合金靶材、复合靶材等。新型靶材具有更好的物理性能、化学稳定性和耐腐蚀性能等，能够满足特殊应用场景的需求，进一步拓展了金属靶材的市场应用范围。

半导体金属靶材行业市场规模未来变化的原因主要包括：

预计各国政策支持力度将加大，推动金属靶材行业稳定增长。

各国政府纷纷出台政策支持半导体产业的发展，包括提供资金补贴、税收优惠、研发资助等，以提高本国半导体产业的竞争力。半导体产业的发展将直接带动金属靶材的需求，从而促进金属靶材市场的增长。此外，为实现碳达峰、碳中和目标，各国政府制定了一系列支持新能源产业发展的政策，包括对太阳能、风能等可再生能源的补贴、优惠电价等。这些政策将推动新能源产业的快速发展，进而带动金属靶材在太阳能电池等领域的应用需求。

新型市场崛起，产业逐步升级转型，预计金属靶材市场进一步发展。

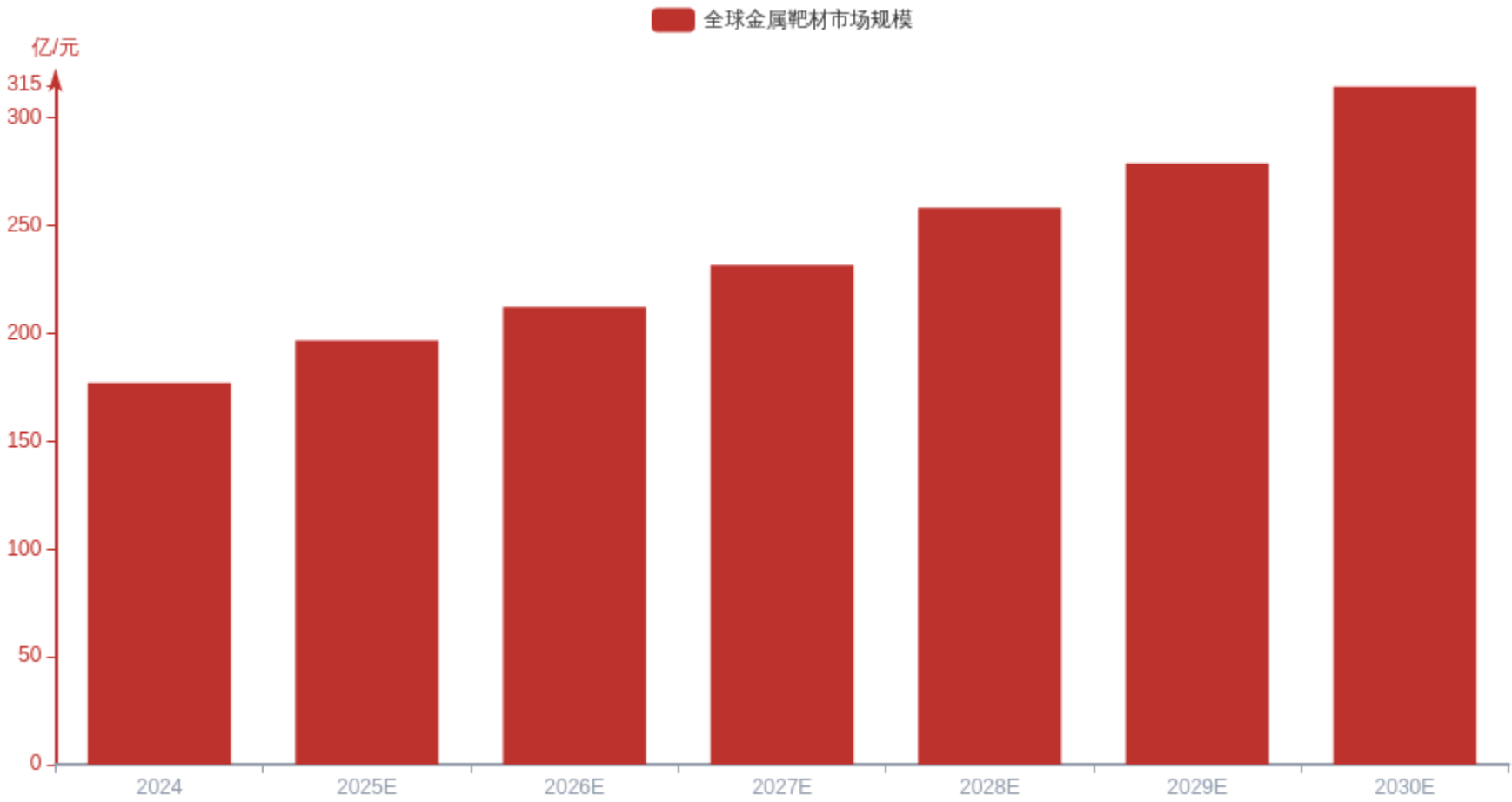
亚洲、南美洲等地区的新兴经济体经济快速发展，对半导体制造、电子产品、太阳能光伏发电等的需求不断增加，推动了当地半导体、显示技术、太阳能电池等产业的发展，从而带动了金属靶材市场的增长。这些新兴市场的产业发展为全球金属靶材市场提供了新的增长空间。此外，全球制造业正朝着高端化、智能化、绿色化方向发展，传统产业的升级改造和新兴产业的崛起将带动对金属靶材等高端材料的需求。汽车行业的电动化、智能化发展，需要使用更多的半导体芯片和显示面板，从而间接带动金属靶材的需求。

规模预测

半导体金属靶材行业规模



全球半导体金属靶材行业规模



数据来源: 专家访谈，中国有色金属网

政策梳理

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《“十四五”原材料工业发展规划》	科技部、工信部、自然资源部发布	2021-01-01	5
政策内容	新材料产业定位为“战略性支柱产业”，半导体超高纯金属作为“关键战略材料”的重要组成部分，享受优先发展待遇，要求加快实现国产化替代，降低对进口的依赖。			
政策解读	该规划是原材料工业整合起来制定的首个规划，体现了系统性、整体性和协同性。通过明确发展目标和任务安排，引导原材料工业向高端化、绿色化、智能化方向发展，加强创新能力建设，突破关键短板材料，提升产业整体竞争力。			
政策性质	规范类政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	工业和信息化部、教育部、科技部、人民银行、银保监会、能源局	2023-01-01	6
政策内容	提出推动以“光储端信”为核心的能源电子全产业链协同和融合发展，提升新能源生产、存储、输配和终端应用能力。加强面向新能源领域的关键信息技术产品开发和应用，让能源电子产业成为推动实现碳达峰、碳中和的关键力量。			
政策解读	半导体金属靶材在光伏等能源电子领域有应用，该政策推动全产业链发展，能带动靶材企业与上下游合作，促进技术创新，为靶材行业在新能源相关半导体应用领域带来发展机遇。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《电子信息制造业2023 -2024年稳增长行动方案》	工业和信息化部、财政部	2023-01-01	7
政策内容	推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能。			
政策解读	政策旨在推动电子信息制造业稳增长，强调电子材料等领域的技术攻关和公共服务平台建设。这将为金属靶材企业提供更好的技术研发支持和公共服务，有助于企业提升技术水平，加快产品研发和产业化进程，提高金属靶材的国产化率和市场竞争力。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工业和信息化部等七部门	2024-01-01	7
政策内容	推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。			
政策解读	政策明确了先进基础材料和关键战略材料的发展方向，金属靶材作为先进半导体材料的重要组成部分，将迎来发展机遇。这将引导金属靶材企业加大研发投入，提高产品性能和质量，满足半导体等高端领域对金属靶材的需求，推动金属靶材产业向高端化发展。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（ 2025-2027年 ）》	工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家标准化管理委员会	2024-01-01	8
政策内容	提出到2027年，推动传统产业深度转型升级、新材料产业创新发展的标准技术水平持续提升。加大高性能靶材制造技术、工艺和装备的研发力度，发布并实施100项以上新材料领域标准，推动10项以上强制性国家标准立项。			
政策解读	该方案为原材料工业优化升级提供了标准引领，强调了高性能靶材制造技术等方面的研发。这将促使金属靶材企业按照更高的标准进行生产和研发，推动企业提升技术水平和产品质量，完善金属靶材产业的标准体系，提高我国金属靶材在国际市场的竞争力。			
政策性质	规范类政策			

竞争格局

半导体金属靶材竞争格局概况

全球金属靶材市场竞争格局呈现高度专业化与集中化。从产业集中度看，全球金属靶材市场呈现明显的寡头垄断特征，日矿金属、江丰电子、普莱克斯、霍尼韦尔、日本东曹、林德、世泰科等巨头占据全球主要份额，把控着全球高端靶材市场的主导权。 从区域分布来看，全球金属靶材产业呈现明显的集群化特征，日本在高端半导体靶材领域占据主要优势，拥有日矿金属、日本东曹等企业，占据40%-45%市场份额；美国则以霍尼韦尔、普莱克斯等公司为主导，占据15%-20%的市场份额，在航空航天和先进芯片用靶材方面具有技术领先性；中国通过产业链协同和政策扶持加速发展，以江丰电子、有研新材、阿石创、隆华科技等企业为代表。

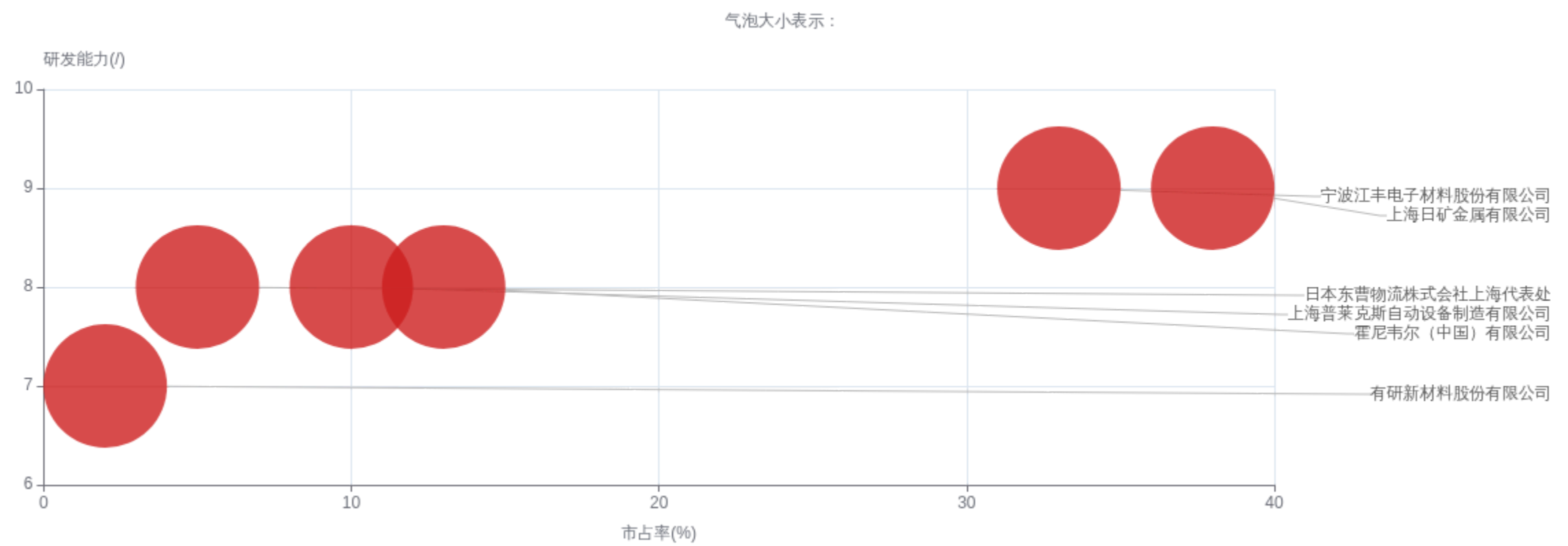
半导体金属靶材行业竞争格局的历史原因

由于国际企业早期的先发优势和技术积累，竞争呈现以国际巨头为主导，中国企业加速追赶的格局。 国际巨头日矿金属凭借先发优势和技术积累，通过垂直整合掌握了从高纯金属提纯到靶材制造的全产业链能力，其产品广泛应用于半导体、平板显示器和光伏电池等领域。霍尼韦尔则在航空航天和半导体用高纯金属靶材领域建立了技术领导地位，拥有多项核心专利和严格的质量控制体系。国际巨头通常与下游设备厂商形成深度绑定关系，通过设备与材料的打包销售模式巩固市场地位。 相比之下，中国金属靶材企业虽然起步较晚，但发展迅猛，已逐步打破国外垄断，实现高端金属靶材国产化能力，国产化正在加速替代。以江丰电子为首的本土企业，通过持续的技术创新和产能扩张，已在各细分领域实现进口替代，并且市场份额正在加速扩大。

半导体金属靶材行业竞争格局未来变化原因

政策支持推动国产化、下游需求增长与应用领域拓展下，金属靶材国产化率将持续提高，本土企业加速发展。

各国政府对半导体、太阳能等产业的支持力度不断加大，出台了一系列相关政策，为金属靶材行业提供了良好的发展环境。中国为推动靶材产业发展，推出了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》等政策，将靶材相关产业列为战略性新兴产业，这将促使国内靶材企业不断提升技术水平，加速国产化进程，进而改变行业竞争格局，打破国际企业在高端靶材领域的垄断。此外，人工智能加速发展，全球半导体市场复苏，使得半导体集成电路用溅射靶材市场保持高速增长态势。同时，新型显示技术如8K超高清、3D显示、柔性显示等的普及，以及商用显示、智能家居等应用场景的扩展，也将推动平板显示用溅射靶材需求的增长，为靶材企业带来更多的市场机会，吸引更多企业进入该领域，加剧市场竞争。



上市公司速览

宁波江丰电子材料股份有限公司（ 300666 ）				有研新材料股份有限公司（ 600206 ）			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	26.3亿元 >	41.8	30.0	-	83.2亿元 >	-29.1	6.3

企业分析

- 1 宁波江丰电子材料股份有限公司【300666】

■ 公司信息			
企业状态	存续	注册资本	26541.6083万人民币
企业总部	宁波市	行业	金属制品业
法人	姚力军	统一社会信用代码	91330200772311538P
企业类型	其他股份有限公司(上市)	成立时间	1113408000000
品牌名称	宁波江丰电子材料股份有限公司	经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；新材料技术研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网应用服务；物联网技术服务；人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

■ 财务数据分析										
财务指标	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025(Q1)
销售现金流/营业收入	0.96	0.95	0.99	0.91	0.95	0.91	1	0.9	0.84	/
扣非净利润同比增长(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率(%)	55.2486	35.5052	57.3541	52.9051	54.0319	49.4806	21.6141	34.1511	49.0432	/
营业总收入同比增长(%)	52.2135	24.2129	18.1187	26.9795	41.4051	36.6356	45.7971	11.8864	38.5667	/
归属净利润同比增长(%)	130.4101	16.552	-8.1612	9.1439	129.2846	-27.5479	148.7226	-3.353	56.7921	/
摊薄净资产收益率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
实际税率(%)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
应收账款周转天数(天)	62.2956	67.8771	68.9682	74.1351	72.4579	70.1896	62.1929	76.6133	83.4083	/
预收款/营业收入	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
流动比率	1.2648	2.3187	1.1548	1.2325	1.1254	1.7698	3.6871	2.2461	1.4157	/
每股经营现金流(元)	0.37	0.1811	0.0234	0.4326	-0.2029	0.4521	0.0621	0.9457	-0.363	/
毛利率(%)	31.8395	31.6529	29.5966	31.0608	28.0954	25.5604	29.9324	29.2024	28.1746	/
流动负债/总负债(%)	67.76	60.6652	94.352	86.2137	84.4555	58.5754	72.1261	59.6388	64.3261	/
速动比率	0.7336	1.4318	0.8328	0.6967	0.627	1.0698	2.3501	1.3924	0.8865	/
摊薄总资产收益率(%)	9.2505	8.3263	5.0114	4.3815	7.4577	3.7678	5.9442	3.882	3.6585	/
营业总收入滚动环比增长(%)	25.1877	15.8243	4.2421	15.7646	3.0133	/	/	/	/	/
扣非净利润滚动环比增长(%)	/	-3.8819	-68.105	577.9165	-94.5585	/	/	/	/	/
加权净资产收益率(%)	20.96	14.98	9.98	9.95	17.15	8.77	11.41	6.25	/	/
基本每股收益(元)	0.33	0.33	0.27	0.29	0.67	0.47	1.11	0.96	1.51	0.59
净利率(%)	12.3052	11.5618	8.9662	7.7271	12.2653	6.2322	10.2145	8.4731	7.5917	/
总资产周转率(次)	0.7518	0.7202	0.5589	0.567	0.608	0.6046	0.5819	0.4582	0.4819	/
归属净利润滚动环比增长(%)	-2.4143	40.9043	-33.8701	68.9407	-46.1555	/	/	/	/	/
每股净资产(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
每股公积金(元)	0.1947	0.8628	0.8628	0.9406	2.0519	2.7072	11.7508	11.5349	11.4773	/
扣非净利润(元)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
存货周转天数(天)	133.3136	129.0184	149.5948	176.7826	177.506	165.4792	182.2508	210.1454	176.6438	/
营业总收入(元)	442808748.02	550025687.03	649683244.58	824964791.18	1166542634.09	1593912652.91	2323878581.81	2601608568.67	3604962847.84	1000450660.01
每股未分配利润(元)	0.5099	0.6453	0.8296	1.0286	1.5305	1.792	2.3224	2.9286	4.2281	/
稀释每股收益(元)	0.33	0.33	0.27	0.29	0.66	0.47	1.11	0.96	1.51	0.59
归属净利润(元)	54940766.33	64034567.92	58808599.14	64185986.25	147168583.7	106626738.28	265204791.62	255474568.79	400564027.03	157212644.92
扣非每股收益(元)	0.27	0.26	0.2	0.15	0.28	/	/	/	/	/
毛利润（元）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
经营现金流/营业收入	0.37	0.1811	0.0234	0.4326	-0.2029	0.4521	0.0621	0.9457	-0.363	/

公司竞争优势

▪ 竞争优势

附录

法律声明



权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、提起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

成为头豹会员—享专属权益

- 成为头豹会员，尊享头豹海量数据库内容及定制化研究咨询服务
- 头豹已累积上万本行业报告、词条报告，拥有20万+注册用户，沉淀100万+原创数据元素
- 头豹优势：行业覆盖全、数据量庞大、研究内容应用场景广泛，并有专业分析师团队为您提供定制化服务，助力企业展业

报告次卡

任意10本报告
阅读权益（一年有效）

¥598 /年

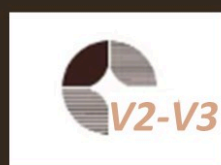
企业标准版



适用于研究频次高的用户或企业
无限量阅读全站报告
升级报告下载量
专享企业服务
定制词条报告

¥50,000 /年

企业专业版/旗舰版



满足定制研究需求的企业用户
定制深度研究报告
按需下载报告
分析师一对一沟通
专享所有核心功能

¥150,000+ /年

购买与咨询

咨询邮箱：

nancy.wang@frostchina.com

客服电话：

400-072-5588



头豹
LeadLeo

www.leadleo.com
400-072-5588